



Dickkupfer

Für hohe Schaltströme in der Automobil- und Industrieelektronik sowie für kundenspezifische Sonderlösungen kommen ein- und doppelseitige Schaltungen sowie Multilayerschaltungen mit Basiskupferschichten von 210-400 μm zum Einsatz. Im Einzelfall sind auch Cu-Schichtdicken von 500 μm möglich.

Bei Multilayern sind insbesondere die Wahl der Prepregs und der Aufbau von großer Bedeutung, um eine porenfreie Einbettung der Cu-Strukturen zu gewährleisten.

Wir stehen Ihnen als Leiterplattenhersteller schon in der Entwicklungsphase beratend zur Seite, um eine fertigungsgerechte und kostenoptimierte Herstellung zu ermöglichen.

Ideal für hohe Ströme

Ihre Vorteile auf einen Blick

- hohe Schaltströme realisierbar
- Randkontaktierung möglich, dadurch größere Auflagefläche
- lokale Erwärmungen können mit Dickkupferanwendungen beherrscht werden

Materialparameter

- Basiskupferschicht zw. 210 μm und 400 μm , in Sonderfällen bis 500 μm
- Material: FR4 bis 6 mm

Beispielhafter Lagenaufbau Dickkupfer

